

お客様各位

富士通株式会社

第 30 回 設計・製造ソリューション展のご案内

拝啓

貴社ますますご清栄のことと心よりお慶び申し上げます。また、平素より格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、この度リード エグジビション ジャパン社主催による『第 30 回設計・製造ソリューション展』が開催されます。

弊社からは、ものづくり・PLM 分野において、お客様の業務革新を力強く支援するソリューションを厳選し、出展いたします。製造業の生産革新への取り組みとして、IoT・AI・ビッグデータなどの ICT が日々進展しています。デジタル化とグローバル化が更に加速する、変化の激しい時代となり、日本の製造業に於いても生き残るための世界的な開発競争力確保に向けた挑戦が続けられています。

弊社といたしましても、そうしたお客様の取り組みを強力にご支援したいという思いで、取組んでいる

“つながるものづくりサービス”を支える各種ものづくり・PLM ソリューションの展示・デモ、及び講演を行わせていただきます。ご多用のところ恐縮に存じますが、是非とも弊社ブースへご来臨賜りますよう、お願い申し上げます。

敬具

- 記 -

1. 会 期 : 2019 年 2 月 6 日(水) ~ 8 日(金) 10:00~18:00 (最終日は~17:00)

2. 場 所 : 東京ビッグサイト 西 2 ホール (小間番号: 西 10-1)

3. 出 展 概 要 :

メインステージ	主要プロダクトのデモやソリューション講演を実施いたします。
展示コーナー	・開発系ソリューション: DIPRO VridgeR、NX、Simcenter 3D、iCAD SX、iCAD MX、FJKSWAD for iCAD、AI を活用した 3D モデル検索 など ・生産系ソリューション: VPS(MFG、GP4、IOC)、デジタルツイン など ・つながる/技術情報管理ソリューション: COLMINA、PLEMIA、Teamcenter など

※出展製品は変更となる場合があります。

4. 会 場 案 内 : ※ブース位置が一部変更になる場合があります。

